

Pressa A Caldo Sottovuoto Da 25 Ton 200X200Mm Con Controllo P-T-T Programmabile

Numero articolo: XP26



introduzione

Progettata per applicazioni di laboratorio impegnative, questa pressa a caldo sottovuoto da 25 tonnellate da tavolo fornisce una sincronizzazione P-T-t precisa, un intervallo di temperatura fino a 500°C, atmosfera di gas inerte/vuoto e adattamento della potenza, abilitando la sinterizzazione ad alta densità e l'incollaggio nella ricerca su batterie allo stato solido, ceramica e compositi. Sistema compatto e certificato CE con derating dinamico della pressione per un'affidabilità a lungo termine.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
R&D Batterie allo Stato Solido	Densificazione e incollaggio interfaccia solido-solido di elettroliti solfuro/ossido ad alta temperatura e pressione.	L'alta tenuta stagna della camera permette la sinterizzazione a mantenimento di pressione a lungo termine sotto N ₂ /Ar, prevenendo l'ossidazione del litio attivo.
Ceramiche Avanzate & Compositi	Sinterizzazione per diffusione in vuoto privo di ossigeno di polveri ceramiche e compositi a matrice non metallica.	La camera in acciaio inossidabile SUS304 con vuoto -0.1 MPa rimuove rapidamente i gas volatili per componenti senza difetti.
Elettronica Flessibile & MLCC	Laminazione a caldo a più fasi di film polimerici e condensatori ceramici multistrato con strati delicati.	La pressione di avvio morbido programmabile fino a 100g previene la frattura di fogli sottili fragili durante la pressatura iniziale.
Saldatura per Diffusione di Metalli	Saldatura per diffusione atomica di metalli/leghe dissimili in vuoto ad alta temperatura.	I piastri rettificati ad alto parallelismo 200x200 mm assicurano una distribuzione uniforme dello stress, minimizzando vuoti e difetti.
Compattazione in Metallurgia delle Polveri	Consolidamento ad alta densità di polveri metalliche, ceramiche e composite sotto vuoto.	Elimina i gas intrappolati, riduce la porosità e migliora la resistenza meccanica e la conduttività elettrica.

Parametro	Configurazione Standard	Configurazione Professionale/Aggiornata
Dimensione Piastra	200 x 200 mm	-
Temperatura Massima	300 °C (raffreddamento naturale)	500 °C (richiede chiller a ricircolo)
Accuratezza Controllo Temperatura	≤ 3 °C	≤ 1 °C
Velocità di Riscaldamento Massima	≤ 3 °C/min	-
Pressione Massima (Stato Freddo)	25 Tonnellate (250 kN)	-
Pressione Massima (Stato Caldo)	-	15 Tonnellate (150 kN) @ 500°C
Accuratezza Controllo Pressione	±0.1 Tonnellata (feedback anello chiuso)	-
Apertura Luce	50 mm	100 mm (adatto per stampi grandi)
Potenza di Riscaldamento	1800 W / 2400 W	3000 W / 3500 W
Dimensione Camera Vuoto	-	400 x 400 x 400 mm

Parametro	Configurazione Standard	Configurazione Professionale/Aggiornata
Materiale Camera	Acciaio Inossidabile SUS 304	-
Vuoto Limite	-0.1 MPa (con pompa a doppio stadio 240 L/min)	-
Metodo Raffreddamento Piastro	Aria ambiente	Chiller a ricircolo esterno
Interfaccia di Controllo	Touchscreen PLC programmabile da 7 pollici	-
Opzioni Alimentazione	AC 220 V / 50 Hz	AC 110 V / 60 Hz o AC 440 V / 60 Hz
Peso Netto (approx.)	270 kg (varia in base alla configurazione)	-
Conformità	Certificato CE	-